

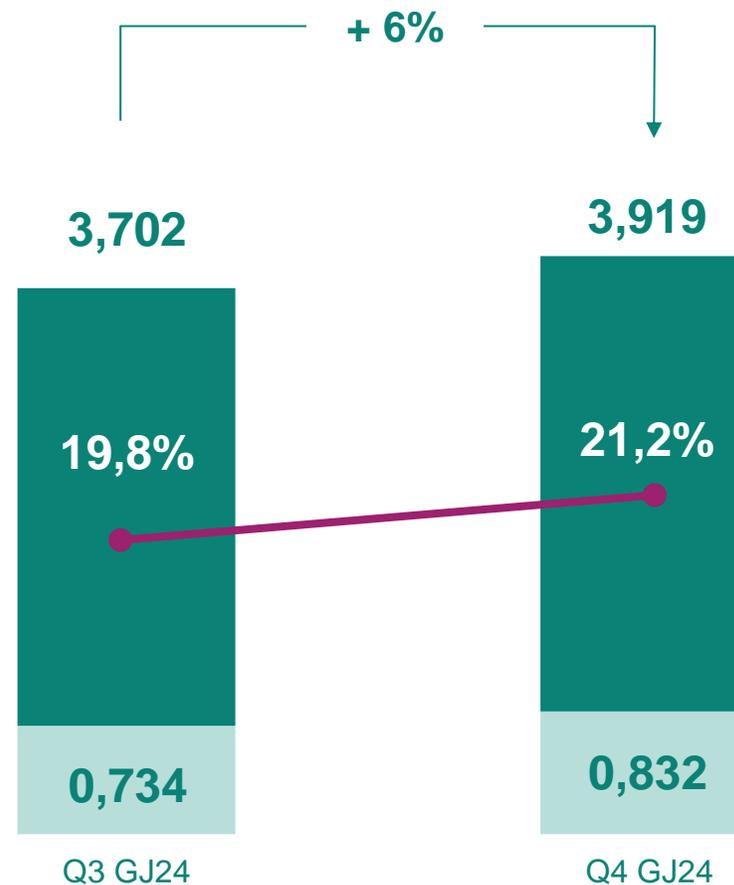


Jahrespressekonferenz 2024

Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender
Infineon Technologies AG | Neubiberg, 12. November 2024

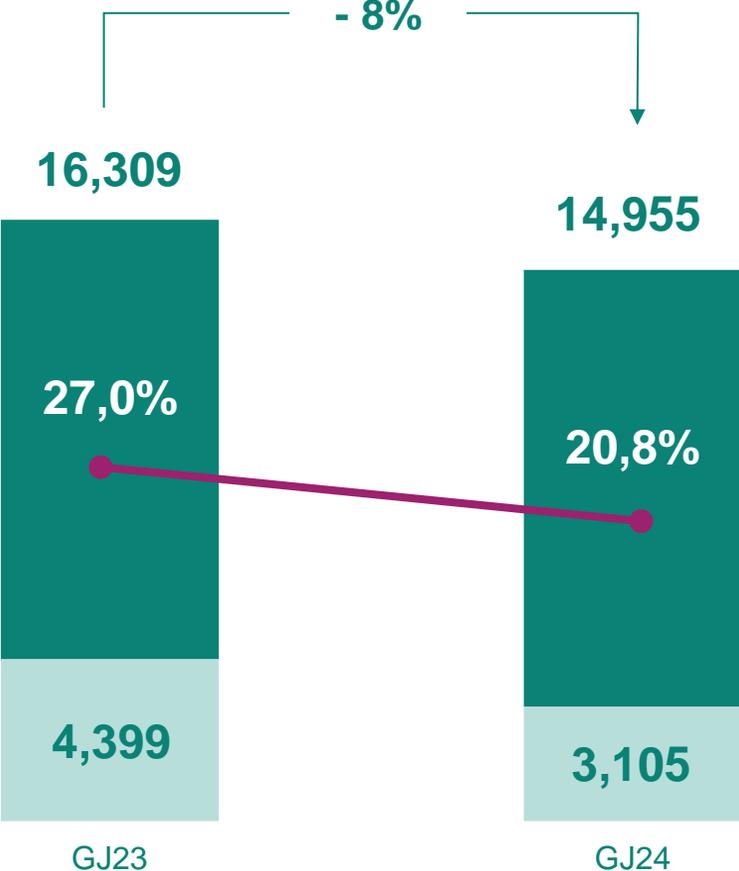


Infineon steigert Umsatz und Ergebnis im vierten Quartal



■ Umsatz in Mrd. Euro
 ■ Segmentergebnis in Mrd. Euro
 — Segmentergebnis-Marge

Geschäftsjahr 2024 im Rahmen der Erwartungen abgeschlossen



Umsatzrückgang nach Rekordgeschäftsjahr 2023

Robuste Profitabilität

Werte im Rahmen der langfristigen, über den gesamten Halbleiterzyklus geltenden Finanzziele

■ Umsatz in Mrd. Euro ■ Segmentergebnis in Mrd. Euro — Segmentergebnis-Marge

Danke!

Den rund 58.000 Mitarbeiter*innen weltweit für ihren Beitrag im Geschäftsjahr 2024.



Vorschlag an die Hauptversammlung: Stabile Dividende von 35 Eurocent je Aktie

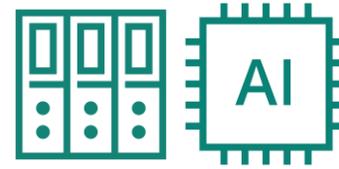


■ Dividendenzahlung in Mio. Euro — Dividende in Euro/Aktie

Infineon ist Wegbereiter für die grüne und digitale Transformation



**Software-definierte
Fahrzeuge**



**Rechenzentren,
insbesondere für
Künstliche Intelligenz (AI)**



Elektromobilität



Erneuerbare Energien



Internet der Dinge (IoT)

Unvermindert große Wachstumschancen für Infineon



**Kommen Sie uns besuchen.
Wir freuen uns auf Sie!**

Halle C3, Stand 502

Stellantis und Infineon vertiefen Zusammenarbeit



Innovationen zur Energieumwandlung und -verteilung für zukünftige Fahrzeugarchitekturen

Wichtige Liefer- und Kapazitätsvereinbarungen unterzeichnet

CoolSiC™ Power-Module



AURIX™ Mikrocontroller



PROFET™ smarte Leistungsschalter



Power für die Energiewende: Unser neuartiges Leistungshalbleiter-Modul für Hochstromanwendungen

Erneuerbare Energien

Elektrifizierung

Energieeffizienz



✓ **90 Prozent weniger Schaltverluste***

✓ **10-mal mehr Strom pro Modul***

✓ **10-mal längere Lebenszeit***

*Verglichen mit dem Stand der Technik eines 3,3kV-Leistungshalbleitermoduls auf Silizium-Basis

Wir werden den Markt für GaN-basierte Leistungshalbleiter prägen

Weltweit erste **GaN-Wafer-Technologie** für Leistungselektronik auf **300-Millimeter-Wafern**

Chipfertigung auf 300-Millimeter-Wafern: **2,3-fache Menge an Chips** pro Wafer

Bestehende 300-Millimeter-Silizium-Fertigungsanlagen auch für 300-Millimeter-GaN-Technologie nutzbar

Infineon stellt dünnsten Silizium-Power-Wafer der Welt vor



Herstellung und Verarbeitung von
ultradünnen Leistungshalbleiter-Wafern

Ermöglicht **Verringerung von Leistungsverlusten**
in Power-Systemen **um mehr als 15 Prozent**

Für zahlreiche Anwendungsbereiche nutzbar

Stärkt Infineon's **Powering-AI-Roadmap**

Führender Anbieter von Power-Systemen: Wir sind Taktgeber bei allen drei Leistungshalbleitertechnologien



Leader in power systems –
mastering all three technologies

Si



SiC



DEUTSCHER ZUKUNFTSPREIS
Preis für die Besten im Bereich
der Technik und Innovation
Nominiert 2024

GaN



Herausragende **Fertigungskompetenz**

Umfassendstes
Technologie- und Produktportfolio

Breites **Anwendungsspektrum**

Ausblick Geschäftsjahr 2025: Gedämpfte Erwartungen in schwachem Marktumfeld



	Ausblick Q1 GJ 2025¹	Ausblick GJ 2025¹
Umsatz	~3,2 Mrd. Euro	Leicht rückläufig im Jahresvergleich
Segmentergebnis-Marge	Im mittleren Zehner-Prozentbereich	Im mittleren bis hohen Zehner-Prozentbereich
Bereinigter/ Berichteter Free-Cash-Flow		~1,7 Mrd. Euro/ ~0,9 Mrd. Euro
Investitionen		~2,5 Mrd. Euro

¹ Dieser Ausblick basiert auf einer Wechselkursannahme von 1,10 US-Dollar für 1,00 Euro

Zusammenfassung

Die zyklische Erholung verläuft nur schleppend. Im Geschäftsjahr 2025 erwarten wir eine leicht rückläufige Umsatzentwicklung.

Wir konzentrieren uns auf die Bereiche, die wir kontrollieren können. Auf diese Weise stärken wir Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit.

Wir festigen unsere Position als Innovationsführer und stellen Infineon optimal für die Zukunft auf.



